

## 混合記憶體立方體聯盟繼續推動 HMC 行業 的採納隨着第二代規範發布

### 第二代規範初稿發佈

加州聖荷西和愛達荷州博伊西，2014 年 2 月 18 日(GLOBE NEWSWIRE) – 致力於為混合記憶體立方體(HMC)技術開發和制定行業標準介面規範的混合記憶體立方體聯盟(HMCC)今日宣佈：其將繼續致力於建立 HMC 生態環境，並通過制定新的介面規範以支援本行業採用該項突破性技術。HMCC 今日還向該聯盟的採納廠商發佈了該規範的第一版初稿，該聯盟的成員不斷在增加，目前已有 120 多位。該新規範支援提高資料傳輸速率，使其短距傳輸 (SR)性能從 10 Gb/s、12.5 Gb/s 和 15 Gb/s 提高到 30 Gb/s。該新規範還將相關的通道模式從 SR 遷移至甚短距傳輸 (VSR)，以便與現有行業術語保持一致。超短距傳輸(USR)的定義也將速度性能從 10 Gb/s 提高至 15Gb/s。

HMCC 由 Micron Technology (納斯達克股票代碼：MU)、Samsung Electronics、和 SK hynix 等領先記憶體供應商所創立，目前已將該規範初稿送至各採納廠商廣泛流傳，以期綜合各位成員的意見，並計畫 2014 年 5 月完成終稿。第一代規範並於 2013 年 4 月公開發表；一些參與制定和採納該規範的公司，包括 Altera、Xilinx、和 Open-Silicon 已開始採用該規範設計使用 HMC 技術的產品和解決方案。

“採用 HMC 第二代規範，設計師就能從我們的 UltraScale FPGA 架構中提取出更高的性能”，Xilinx 產品組合和解決方案行銷副總裁 Hugh Durdan 說。“我們目前正在發運的 UltraScale 設備已設計為支援該規範，以便向高頻寬用於市場提供風險更低、速度更高的產品”。

“第二代 HMC 規範使介面的資料傳輸速率提高一倍，這使得系統設計師能利用下一代 20 納米和 14 納米 FPGA 以及 SoCs 更容易地實現性能的提高”，Altera 產品行銷高級總監 Patrick Dorsey 說。“我們很早就開始提供評估板，並演示證明了 HMC 設備和 FPGA 之間的互通性，使客戶立即就能開始評估和開發基於 HMC 的高性能系統”。

該聯盟是由一群原始設備供應商、促進商和集成商密切合作的產物，這些廠商共同合作開發和實施關於由 Micron 開發的高性能記憶體解決方案 HMC 的開放介面標準。開發商成員 Micron Technology, Inc.、Samsung Electronics Co., Ltd.、Altera Corporation、ARM、IBM、Microsoft Corporation、Open-Silicon, Inc.、SK hynix, Inc.和 Xilinx, Inc.正與採納廠商直接合作以支持創建 HMC 的新市場和行業採納的整體需求。

本行業突破性的 HMC 採用了先進的矽穿孔(TSV)技術，其通過垂直導管將一組單獨的晶片在電氣性相連接，以將高性能邏輯電路與動態隨機存取記憶體(DRAM)模具相結合。Micron 正在提供第一款商用 HMC 產品的樣品，該產品密度為 2GB，存儲頻寬達空前的 160 GB/s，而每比特能耗比現有技術少 70%，這大幅度地降低了客戶的擁有總成本。

DRAM 的性能改進率和處理器資料消耗率之間的差距不斷地增大，而 HMC 已被行業領袖和有影響人士視為解決該問題期盼已久的答案。HMC 的性能代表著其性能、封裝和能效等方面遠超於當前和近期的記憶體架構，與現有的記憶體技術有巨大的差別。

歡迎成為 HMCC 成員

有志於參與 HMC 規範制定的任何公司均可成為 HMCC 的採納商會員。可在 [www.hybridmemorycube.org](http://www.hybridmemorycube.org) 上獲取關於採用該技術的更多資訊、技術支援說明以及其他工具。

關於 HMCC

混合記憶體立方體聯盟(HMCC)由世界半導體行業頂級成員所創立，其宗旨是為混合記憶體立方技術制定和建立行業標準介面規範。該聯盟成員包括 Altera、ARM、IBM、Micron Technology、Microsoft、Open-Silicon、Samsung、SK hynix 和 Xilinx。欲知關於 HMCC 的更多資訊，請訪問 [www.hybridmemorycube.org](http://www.hybridmemorycube.org)。

聯繫方式: Mary Ellen Ynes

Zeno Group for Micron  
+1.650.801.7954  
maryellen.ynes@zenogroup.com

John Lucas  
Samsung Electronics Co., Ltd.  
+1.408.544.4363  
j.lucas@ssi.samsung.com